

食品温度80—90度Cで密閉

東京食品機械が包装装置

東京食品機械（東京都中央区、秦哲志社長、03・3663・4006）は、食品温度が80—90度Cのままガス置換包装（MAP）ができる包装装置「ホットMAP」を開発した。従来、温度が高い食品は真空包装ができなかった。パック内の気圧を低下せずにパック内を無酸素にする新しい技術により実現した。同装置をラインアップに追加することで、包装機の拡販に弾みを付ける。

ガス置換式で拡販に弾み



開発した「ホットMAP」で包装した食品

MAPはパック内の空気を混合ガスに置き換えることで、細菌の繁殖や酸化を抑制する包装方式。使用するガスは窒素、酸素、二酸化炭素の3種類で、これらの組み合わせで、総菜なら3日から1週間、加工品は1週間から1カ月間に消費期限を延ばせるという。ホットMAPは包装

機に装着して使用する。シール性やガスバリアー性に加え、耐熱性に優れるため、密閉後の高温殺菌ができるのが特徴。ホットMAPで使用するフィルムは、ポリプロピレン（PP）、ナイロン（NY）、エチレン・ビニルアルコール共重合樹脂（EVOH）、PPの4層で、厚さは60—90ミクロン（マイクロは100万分の1）。

同社は「MAPでフードロス（食料廃棄）をなくす」（秦社長）ことを目的に、2016年からスーパーのパックセンターや食品工場向けにMAPの導入提案を開始。またスーパーから要望の多い「嵌合MAP」を中央化学、三菱ケミカルと共同開発するほか、ラップ包装に換わる「ポリユームMAP」も中央化学と共同開発しており、順次、市場投入していく方針だ。

同社は独ドルチパック製のトレーシーラーなどを輸入販売している。装置価格は1300万—5000万円（消費税抜き）。国内市場シェアは約7割を占め、既存顧客は約200万円程度でホット

MAPなどの装置を追加導入できるといふ。10月2日から東京・有明の東京ビッグサイトで開催される「2018東京国際包装展」に出展する。